

Board thickness Through hole Diameter	Board thickness													
	25 μm	50 μm	75 μm	100 μm	125 μm	150 μm	200 μm	300 μm	500 μm	600 μm	700 μm	800 μm		
50 μm	> 90 % < 10 μm 45 min.	> 90 % < 10 μm 45 min.	> 90 % 10 μm 60 min.	> 90 % 10 μm 60 min.	> 90 % > 10 μm 90 min.									filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
75 μm	> 90 % 10 μm 60 min.	> 90 % 10 μm 60 min.	> 90 % > 10 μm 75 min.	> 90 % < 15 μm 45 min. < 30 min.	> 90 % 15 μm 60 min. < 30 min.	> 90 % > 15 μm 60 min. < 30 min.								filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
100 μm	> 90 % < 15 μm 30 min. < 30 min.	> 90 % 15 μm 45 min. < 30 min.	> 90 % > 15 μm 60 min. < 30 min.	> 90 % < 20 μm 75 min. < 30 min.	> 90 % 20 μm 60 min. 30 min.	> 90 % > 20 μm 75 min. < 30 min.	> 90 % > 25 μm 60 min. 45 min.							filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
125 μm		> 90 % > 15 μm 45 min. 30 min.	> 90 % < 20 μm 60 min. < 30 min.	> 90 % 20 μm 60 min. 30 min.	> 90 % > 20 μm 75 min. < 30 min.	> 90 % < 25 μm 75 μm 30 min.	> 90 % 25 μm 90 μm 30 μm	> 90 % 30 μm 90 min. 60 min.						filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
150 μm	> 90 % 20 μm 45 min. 45 min.	> 90 % 20 μm 60 min. 30 min.	> 90 % > 20 μm 75 min. < 30 min.	> 90 % < 25 μm 75 min. 30 min.	> 90 % 25 μm 75 min. 45 min.	> 90 % > 25 μm 90 min. 45 min.	> 90 % 35 μm 90 min. 60 min.	> 90 % 45 μm 90 min. 90 min.						filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
200 μm	> 90 % 25 μm 45 min. 60 min.	> 90 % 25 μm 60 min. 60 min.	> 90 % 25 μm 75 min. 45 min.	> 90 % 30 μm 75 min. 60 min.	> 90 % 30 μm 90 min. 60 min.	> 90 % 35 μm 105 min. 60 min.	> 90 % 45 μm 120 min. 60 min.	> 90 % 50 μm 120 min. 75 min.	> 90 % 55 μm 120 min. 90 min.					filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
250 μm						> 90 % 45 μm 120 min. 45 min.	> 90 % 50 μm 120 min. 60 min.	> 90 % 55 μm 120 min. 90 min.	> 90 % 65 μm 180 min. 90 min.	> 90 % 70 μm 210 min. 90 min.				filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
300 μm						> 90 % 55 μm 120 min. 75 min.	> 90 % 55 μm 120 min. 60 min.	> 90 % 60 μm 150 min. 60 min.	> 90 % 65 μm 180 min. 90 min.	> 90 % 70 μm 210 min. 90 min.	> 90 % 70 μm 240 min. 90 min.			filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700
350 μm		The values are standard ones and may vary dependent on the hole conditions											> 90 % 80 μm 240 min. 120 min.	filling level copper on top plating time THF plating time AVF 700